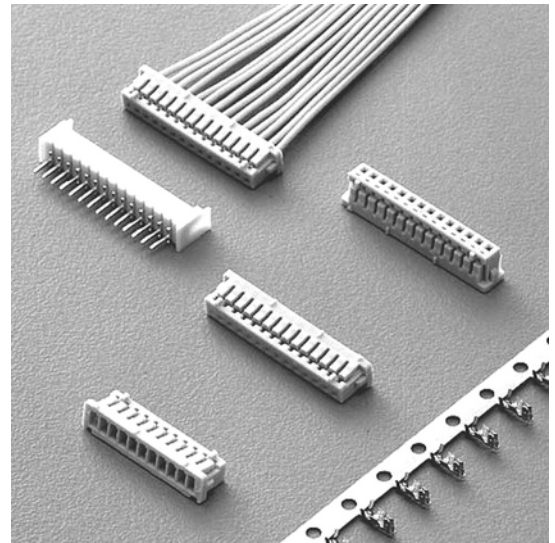


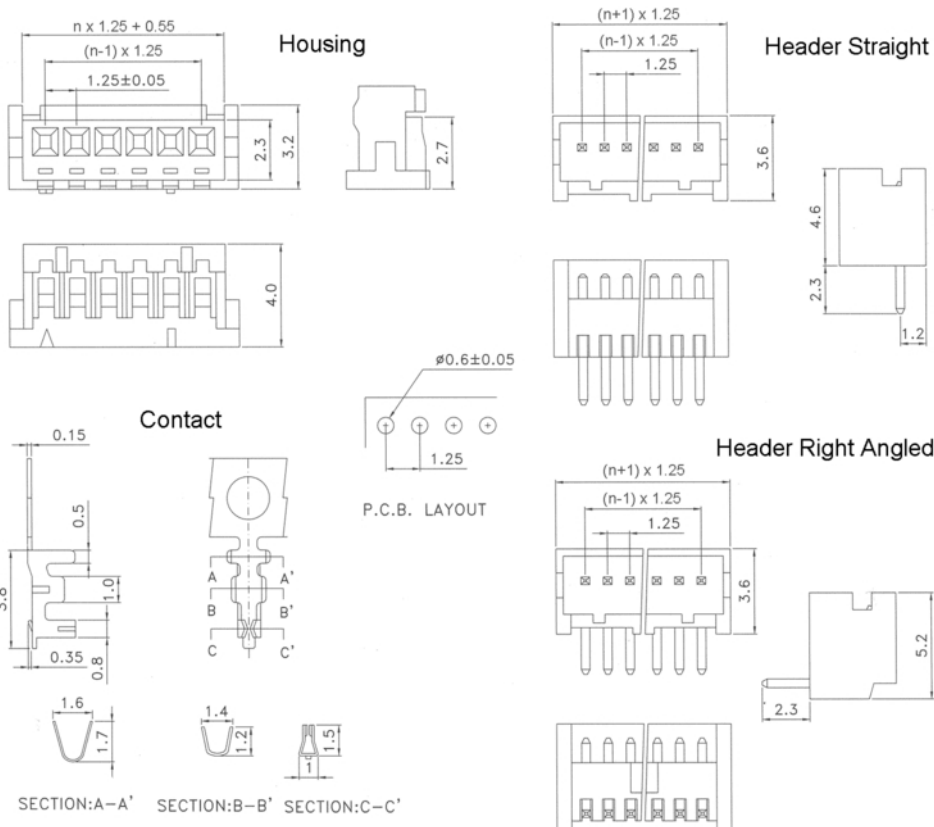
## Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch, Straight/Right-Angled

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 28 ... 32
Applicable wire Gauge	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 30mΩ
Contact Resistance	< 30mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	100V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Type*</b>	<b>Plating</b>
<b>563</b>	<b>15</b> 02-15	<b>4</b> 1 Buchsengehäuse Housing 2 Buchsenkontakte Crimp contacts 3 Stiftleiste gerade Straight pin header 4 Stiftleiste gewinkelt Right-angled pin header	<b>50</b> 50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not used for housings)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
 FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
 WEBSITE www.wpro.com

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*

